

1927

1927

1927

1927

47

1947

1947

1947

1977

1977

1977

1977

977



A. OMODEO METALLEGHE

resistann

**Stagno e leghe
per una tecnologia
sempre più raffinata
ed esigente**

A. OMODEO METALLEGHE

20128 MILANO - Via Pontenuovo, 51 - Tel. 26.600.23 - 25.660.13

Stabilimento: AGRATE - Via Talete, 6 - Tel. 039/65.08.28

lativa alla quale dobbiamo solo aggiungere che l'esperienza degli ultimi anni ci ha fatto constatare che la nostra clientela ha un consumo molto limitato di flusso data la sua attività e il buon rendimento usandolo molto diluito con l'opportuno nostro SOLVENTE T2 a base di alcool isopropilico. Ciò lo rende molto più economico a parità di prezzo unitario rispetto ad altri prodotti. Inoltre resta molto avvantaggiata la pulizia del circuito nella fase finale in modo tale da potersi eliminare il lavaggio anche nei casi delle apparecchiature più esigenti.

RESIFLUX T 2

Il flussante nella stagnatura dei circuiti stampati è di importanza basilare. Deve unire le caratteristiche di completo isolamento a stagnatura effettuata e nello stesso tempo avere una buona capacità detergente sui circuiti stampati immagazzinati da tempo o anche leggermente ossidati a seguito di manipolazioni durante il montaggio senza che ciò sia a danno dell'isolamento.

Altro elemento da tener ben presente è la caratteristica dei fumi che si svolgono durante l'operazione di stagnatura che non devono essere corrosivi e perciò dannosi condensandosi sulle parti fredde dei componenti del circuito.

Il flusso è inoltre molto importante per quanto riguarda il risultato finale della saldatura con riferimento alla lucentezza e apparenza esteriore, oltre che per la netta definizione del circuito.

Per rispondere a questo scopo il flusso deve avere una grande aderenza alle superfici di stagno tale da creare nella superficie interfacciale metallo liquido-flusso una condizione di maggior tensione superficiale del metallo per creare superfici arrotondate e lucide, pur disponendo di leghe a bassa tensione (*) superficiale, tali da permettere una buona bagnabilità dei componenti e delle superfici ramate e una buona penetrabilità per capillarità nei fori specialmente quando ramati internamente.

Nello stesso tempo il flusso deve poter essere utilizzato sciolto in solventi in concentrazioni non troppo elevate in maniera da permettere residui il più possibile ridotti tali da lasciare la superficie del circuito con poco residuo di colofonia asciutta e non gommosa anche nei casi in cui il circuito non venga lavato.

Resiflux

Il ns. RESIFLUX T2 risponde a tutte queste caratteristiche ed è composto con solventi evaporabili, ma abbastanza stabili per cui anche in apparecchi di flussaggio a schiuma non cambia la densità del flusso per evaporazione del solvente che molto lentamente, evitando fenomeni di ricristallizzazione della

(*) Vedi ns. lega per circuiti « LOWTERM ».

colofonia e difficoltà nella produzione di schiuma o flussaggi troppo densi.

Il ns. RESIFLUX T2 è al 50% di resina solida attivata e può e deve essere ulteriormente diluito con l'apposito solvente, quando si voglia una flussatura più blanda o schiuma più leggera, fino a dimezzare la percentuale di resina solida contenuta.

Densità utile per il flussatore a schiuma da 0,880 - a 0,920.

Il RESIFLUX T2 accoppia alla buona caratteristica disossidante una buona stabilità sul metallo fuso con un comportamento simile all'olio che lo differenzia nettamente da una colofonia normale che, come ognuno può constatare, posta su del metallo fuso o anche scaldata con un saldatore tende a sfuggire verso le parti fredde.

Questa caratteristica del RESIFLUX T2 riduce notevolmente i fenomeni stalattitici che con un'opportuna inclinazione dell'onda e della linea di scorrimento possono essere annullati completamente anche senza ricorrere alla stagnatura con miscelatore d'olio il che coinvolge altri problemi susseguenti di lavaggio e di scelta dei componenti.

Il residuo di colofonia per le caratteristiche già dette tende a rimanere preferenzialmente come un velo protettivo sulle superfici metalliche stagnate anziché sulle parti isolanti con un risultato di grande pulizia del circuito.

N.B. - Il RESIFLUX T2 corrisponde alle Norme di qualificazione MIL -F - 14256/C ed equivale al flusso tipo RMA per fili autosaldanti secondo Norme QQ-S- 571 d.

Il SOLVENTE T2 a base di alcool isopropilico è di composizione studiata intenzionalmente per favorire la solubilità degli attivanti del RESIFLUX T2 per reintegrare le perdite per volatilizzazione ed il consumo di solvente. Non contiene tuttavia attivanti e prodotti che facilitino la saldatura.

Una continua reintegrazione di solvente senza aggiunta di flusso fresco porta perciò ad avere una resina poco attiva per il flussaggio. Il SOLVENTE T2 può essere anche usato per allungare l'ANOSSIFLUX S3 a solvente organico.

Il PROTETTIVO CS per circuiti stampati è a base di resina polimerizzata e plastificata onde evitare le screpolature ad essiccazione avvenuta e conseguente deterioramento dei circuiti.

I solventi sono i medesimi del RESIFLUX T2, perciò il prodotto è perfettamente compatibile con le operazioni di flussaggio successive, e garantiscono una perfetta e immediata solubilità e miscelabilità con il flussante prima della stagnatura.

Può essere applicato a spruzzo, schiuma e a pennello anche su superfici non perfettamente asciutte (umide, ma non bagnate) favorendo la perfetta essiccazione.

Solvente T2

Protettivo CS